

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015 年 3 月 5 日(05.03.2015)

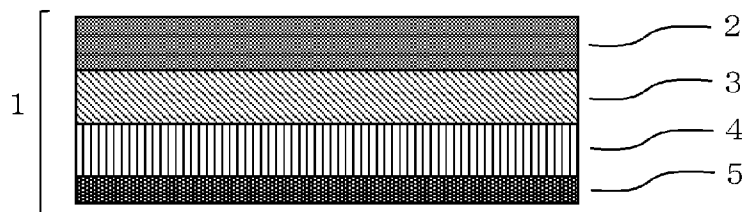


(10) 国際公開番号
WO 2015/029867 A1

- (51) 国際特許分類:
B65D 73/02 (2006.01) **B32B 27/32** (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01) **B65D 65/40** (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01) **B65D 85/86** (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/071865
- (22) 国際出願日: 2014 年 8 月 21 日(21.08.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-181511 2013 年 9 月 2 日(02.09.2013) JP
- (71) 出願人: 電気化学工業株式会社(DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 豊田 渡(TOYOTA Wataru); 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 徳永久次(TOKUNAGA Hisatsugu); 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 岩崎 貴之(IWASAKI Takayuki); 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 佐々木 彰(SASAKI Akira); 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 杉本 和也(SUGIMOTO Kazuya); 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP).
- (74) 代理人: 園田 吉隆, 外(SONODA Yoshitaka et al.); 〒1630434 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号 新宿三井ビル 3 4 階 園田・小林特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: COVER FILM AND ELECTRONIC COMPONENT PACKAGE

(54) 発明の名称: カバーフィルムおよび電子部品包装体



(57) Abstract: Disclosed are: a cover film in which a base material layer, an intermediate layer, a peeling layer, and a heat seal layer are disposed in the stated order, wherein the peeling layer contains a resin composition essentially comprising 50-80 mass% of one or more copolymers selected from styrene-diene block copolymers and styrene-diene graft copolymers, and 50-20 mass% of an ethylene- α -olefin copolymer, the Vicat softening temperature is 55-80°C, and the heat seal layer contains a styrene-(meth)acrylate copolymer having a styrene content of 50-80 mass%; and an electronic component package using the cover film as a carrier tape lid.

(57) 要約: 基材層、中間層、剥離層、ヒートシール層がこの順に配置されたカバーフィルムであって、剥離層が、スチレン-ジエンブロック共重合体およびスチレン-ジエングラフト共重合体から選択される 1 種以上の共重合体 50～80 質量%と、エチレン- α -オレフィン共重合体 50～20 質量%とから本質的になる樹脂組成物を含有し、ビカッ軟化温度が 55～80°C であり、ヒートシール層が、スチレン含有率が 50～80 質量%のスチレン (メタ) アクリレート共重合体を含有するカバーフィルム、および該カバーフィルムをキャリアテープの蓋材として用いた電子部品包装体が開示される。



WO 2015/029867 A1